

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和4年5月13日(2022.5.13)

【公開番号】特開2021-55113(P2021-55113A)

【公開日】令和3年4月8日(2021.4.8)

【年通号数】公開・登録公報2021-017

【出願番号】特願2020-218278(P2020-218278)

【国際特許分類】

C 08 L 101/00(2006.01)

10

C 08 K 7/02(2006.01)

H 01 L 23/00(2006.01)

H 01 L 23/29(2006.01)

【F I】

C 08 L 101/00

C 08 K 7/02

H 01 L 23/00 C

H 01 L 23/30 R

【手続補正書】

20

【提出日】令和4年5月2日(2022.5.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

電子部品を有し、

前記電子部品は、樹脂と電磁波シールド性フィラーとを含むインサート成形用樹脂組成物により前記電子部品の表面上に形成された電磁波シールド層を含む樹脂成形物により封止されており、

前記電子部品の表面に垂直な方向における前記樹脂成形物の断面において、前記電子部品の表面に近い方の領域における $200 \mu m$ 四方当りの前記電磁波シールド性フィラーの個数A(個/ $40,000 \mu m^2$)は、前記樹脂成形物の表面に近い方の領域における $200 \mu m$ 四方当りの前記電磁波シールド性フィラーの個数B(個/ $40,000 \mu m^2$)の1.05倍以上であり、

前記電磁波シールド性フィラーの表面は、絶縁性材料で被覆処理されておらず、

前記電磁波シールド性フィラーの少なくとも一部は、前記電子部品に接触している電子部品の封止体。

【請求項2】

前記樹脂は、熱可塑性樹脂、及び熱硬化性樹脂よりなる群から選択される少なくとも1種である請求項1に記載の電子部品の封止体。

【請求項3】

前記電磁波シールド性フィラーは、導電性フィラーである請求項1または2に記載の電子部品の封止体。

【請求項4】

前記電磁波シールド性フィラーは、アスペクト比が1.5以上である請求項1~3のいずれかに記載の電子部品の封止体。

【請求項5】

30

40

50

前記熱可塑性樹脂は、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、及びポリウレタン系樹脂よりなる群から選択される少なくとも1種である請求項2に記載の電子部品の封止体。

【請求項6】

前記熱硬化性樹脂は、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂、不飽和ポリエステル系樹脂、ジアリルフタレート系樹脂、ウレタン(メタ)アクリレート系樹脂、及びポリイミド系樹脂よりなる群から選択される少なくとも1種である請求項2に記載の電子部品の封止体。

10

20

30

40

50